

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN(11)Publication number : **54-128274**(43)Date of publication of application : **04.10.1979**

(51)Int.Cl.

H01L 23/30**H01L 23/48**(21)Application number : **53-035509**(71)Applicant : **HITACHI LTD**(22)Date of filing : **29.03.1978**(72)Inventor : **MASUDA AKIRA
TAIRA YASUO****(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE****(57)Abstract:**

PURPOSE: To reduce the feedback capacity for the device to be used suitably at the high frequency region by forming the tip of the lead for earth into a disk shape with the semiconductor pellet provided at the center of the disk and then covering the pellet and the tips of plural leads of the pellet.

CONSTITUTION: Tip A of lead 2a for source S is formed into a disk, and semiconductor pellet 3 is attached at the center of disk part A. Then lead 2b for drain D, lead 2c for 2nd gate G2 and lead 2d for 1st gate G1 are provided in three directions centering on pellet 3, and mold part 1 is formed covering over the tip parts of these leads as well as pellet 3. Here, the contact area is increased between part 1 and lead 2a for the source to be earthed, and the feedback capacity is reduced. Thus, the device can be used suitably at the high frequency region.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑫公開特許公報(A)

昭54—128274

⑤Int. Cl.²
H 01 L 23/30
H 01 L 23/48

識別記号 ⑥日本分類
99(5) C 22
99(5) C 21

庁内整理番号 ④公開 昭和54年(1979)10月4日
7738—5F
7357—5F

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭樹脂封止型半導体装置

⑱特 願 昭53—35509

⑳出 願 昭53(1978)3月29日

㉑発 明 者 増田章
高崎市西横手町111番地 株式
会社日立製作所高崎工場内

㉒発 明 者 平保夫

高崎市西横手町111番地 株式
会社日立製作所高崎工場内

㉓出 願 人 株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目5
番1号

㉔代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

発明の名称 樹脂封止型半導体装置

特許請求の範囲

1. 少なくとも接地端子として使用されるリードを含むリード群と、半導体素子とを有し、この半導体素子とリード先端部とを樹脂材料によつて封止してなる半導体装置において、前記接地端子として使用されるリードと前記樹脂封止体との接触面積を大きくすることによつて容量シールドを図つたことを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

発明の詳細な説明

本発明は半導体装置、特に樹脂材料によつて素子部が封止された半導体装置(例えばレジンモールド型半導体装置)に関する。

最近、第1図に示すようなレジンモールドフラットパッケージ型トランジスタが提案されている。このトランジスタは素子部をレジン等の樹脂材料で封止した円筒形状の封止体(モールド)部1と、素子の電極に接続され、かつモールド部1の4方

に突出するリード2とからなる。このトランジスタの内部構造は例えば、第2図(a)(b)、又は第3図(a)(b)のようになっている。

第2図はデュアルゲート型電界効果トランジスタ(以下単にデュアルゲートFETと称す)の内部構造を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。図中鎖線1がモールド部であり、2a~2dはリード、3は半導体ベレットである。このデュアルゲートFETは高周波特性が良かったためテレビジョンにおけるチューナのRF(高周波)アンプに用いられる。

第3図はバイポーラトランジスタの内部構造を示すものであり、同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。図中鎖線部1がモールド部、2a~2dがリード、3は半導体ベレットである。ここで、それぞれリード2aはコレクタ(C)、2bはエミッタ(E)、2dはベース(B)端子として使用されるが、残りのリード2cは不使用端子(NC)である。このようなバイポーラトランジスタも高周波用として利用される。

かかる構造のトランジスタは封止材料としてレジンを使用しているため、今迄のキャン封止型トランジスタ（素子部を絶縁材料を介して金属材料で覆った構造のトランジスタ）に比較して低価格化が図れること、さらには、モールド部1の側方から水平に4本のリードを突出させる、いわゆるフラットパッケージ型とすることにより、モールド部底部から下方にリードを突出させる今迄のトランジスタよりも、リード間の距離Lを長くすることができるため、出力容量の減少化が図れる等の特徴を有する。

ところで、このようなレジンモールド型トランジスタにあつては、帰還容量が例えば0.15 pFにもなり、キャン封止型のもの（例えば0.01 pF）に比し10倍もの容量値を有することが判明した。これは、キャン封止型のものはキャン部を接地するような構造としているため封止部の浮遊容量を小さくできるのに対し、レジンモールド型にあつてはこのような容量シールドを行なっていないため、モールド部での浮遊容量が大きくな

ることが原因と思われる。このため、レジンモールド型のトランジスタを高周波用として使用した場合、帰還容量が大きくなり寄生共振等を生じ、UHF帯、VHF帯の周波数領域での使用が不可能になるという問題を有する。

本発明はかかる問題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは帰還容量を減少せしめることのできる樹脂封止型半導体装置を提供することにある。他の目的は高周波領域での使用に適したレジンモールド型トランジスタを提供することにある。

以下実施例により本発明を具体的に説明する。

第4図は、本発明をレジンモールド型デュアルゲートFETに適用した場合の一例を示す構造図であり、同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。同図(a)には、先端部Aが円板状に形成されたソース(5)用のリード2aと、このソース用のリード2aの先端円板部A中央に取付けられた半導体ベレット3と、この半導体ベレット3を中心として3方に配設されるドレイン(6)用のリード2b、第2ゲート(G_2)用の

リード2c、第1ゲート(G_1)用のリード2d、及びこれらのリードの先端部と半導体ベレットとを覆うように形成されたモールド部1（図中鎖線で示す）とからなるデュアルゲートFETが示されている。なお、各リードは半導体ベレット3の電極部と細線（ワイヤ）により接続される。そして、前記ソース用リード2aは同図(b)に示すように先端部がL字状に折曲されており、このL字状先端部Aが他のリード2b～2d先端部直下に位置するようにモールド部1の底部に配設されている。なお、このソース用リード2aの他端は使用時には接地されることになる。このようにして接地されるソース用リード2aとモールド部との接触面積を大きくすることにより浮遊容量を小さくすることができる。

第5図は本発明をバイポーラトランジスタに適用した場合の一例を示す構造図であり、同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。同図(a)には、先端部Aが円板状に形成されたリード2c（これはトランジスタの動作に関係のないリードNCであ

る）と、このリード2cの円板状先端部Aを中心として3方に配設されるコレクタ(c)用のリード2a、エミッタ(6)用のリード2b、ベース(5)用のリード2dと、コレクタ用リード2aの先端幅広部に取付けられた半導体ベレット3、及びこれらを封止するモールド部1（図中鎖線部）とからなるトランジスタが示されている。そして、前記リード2cは同図(b)に示すように、先端部AがL字状に折曲されており、このL字状先端部Aが他のリード2a、2b、2dの先端部直下に位置するようにモールド部1の底部に配設される。また、コレクタ用リード2aの幅広先端部は前記リード2cの円板状先端部Aの中央上部に位置するように配設されている。また、通常は不使用リード2cの他端は接地される。このようにして接地されるリード2cとモールド部との接触面積を大きくすることにより浮遊容量を小さくすることができる。

以上説明した本発明によれば、デュアルゲートFETにおいてはソース用端子の先端部の面積を

大きくすることにより、また、バイポーラトランジスタにおいては不使用端子の先端部の面積を大きくすることにより、共にモールド部との接触面積を大とすることができるからモールド部の浮遊容量を減少させることができる。すなわち、リード先端部円板が容量シールドとして機能することとなる。ちなみに、本願発明者等の実験によれば、掃過容量は0.012 pFとなり、ほぼキャン封止型のもとの同一の値に抑えることができるという良好な結果が得られた。したがって、かかるレジンモールド型トランジスタを高周波用として利用することが十分可能になる。

本発明は前記実施例に限定されない。例えば前記実施例では容量シールド部を円板形状としたが、これに限らず、モールド部との接触面積を大きくすることができるような形状であればどのような形状であつてもよい。また、先端部が円板状に形成されたリードは必ずしも使用時において直接接地される必要はなく、接地電位に近いような低い電位に保たれるようになつていればよい。

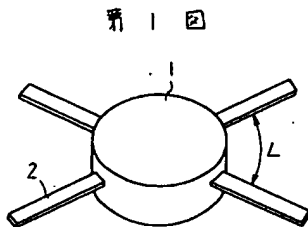
本発明はフラットパッケージ型のものに限定されず、全てのレジソモールド型トランジスタに広く利用できる。

図面の簡単な説明

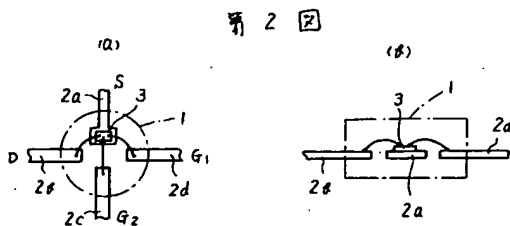
第1図はフラットパッケージ型トランジスタの構造を示す斜視図、第2図はデュアルゲートFETの構造の一例を示すものであり同図(a)は平面図、(b)は正面図、第3図はバイポーラトランジスタの構造の一例を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図、第4図は本発明をデュアルゲートFETに適用した場合の一例を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図、第5図は本発明をバイポーラトランジスタに適用した場合の一例を示すものであり同図(a)は平面図、同図(b)は正面図である。

1…モールド部、2, 2a~2d…リード、3…
ペレット。

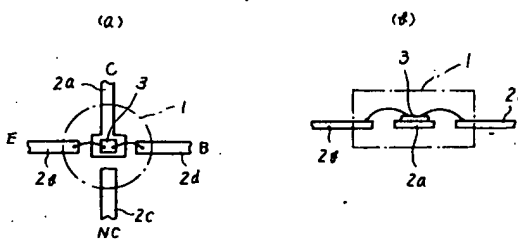
代理人 弁理士 薄田利幸



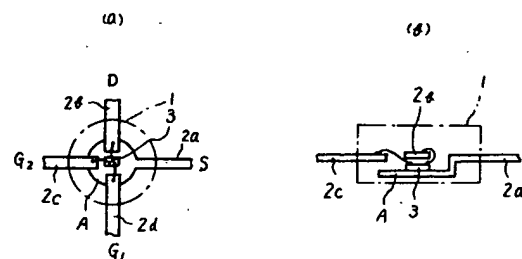
第 1 圖



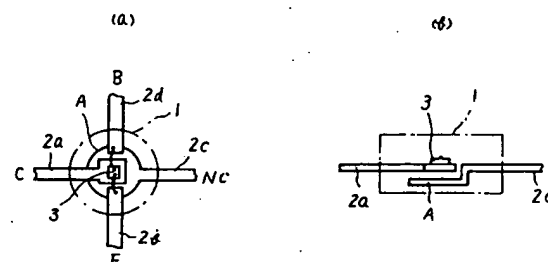
第 2 回



第 3 圖



第 4 回



第 5 圖